

**USB3.1C S1H DN1 RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	OMINMATE Data – USB-Buchse, USB Buchsen, 10 Gbit/s, SMD-Lötanschluss, 90°, ≥ 10000, Raster in mm (P): 0.50 mm, Polzahl: 24, LCP, schwarz, Rolle
Best.-Nr.	<a href="#">2987560000</a>
Art	USB3.1C S1H DN1 RL
GTIN (EAN)	4099986855052
VPE	1.050 Stück
Verpackung	Rolle

Erstellungs-Datum 7. Juni 2024 01:28:42 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7,9 mm	Tiefe (inch)	0,311 inch
Höhe	3,21 mm	Höhe (inch)	0,126 inch
Breite	8,94 mm	Breite (inch)	0,352 inch
Nettogewicht	10 g		

## Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ	Nennspannung	5 V
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	750 V AC		

## Systemkennwerte

Abgangswinkel	90°	Anzahl Lötstifte pro Pol	1
Leistungs-Kategorie	10 Gbit/s	Lötstiftlänge (l)	1,15 mm
Lötverfahren	Reflow-Löten, Handlöten	Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss
Polzahl	24	Produktfamilie	OMINMATE Data – USB-Buchse
Raster in Zoll (P)	0,02 "	Raster in mm (P)	0,5 mm
Schirm tabs	keine	Schirmmaterial	Messing
Schirmoberfläche	vernickelt	Schirmung	360°-Schirmkontakt
Schutzart	IP20	Seitenabschluss, Eigenschaft	Keine
Steckzyklen	≥ 10000	Übertragungsrate	10 Gbit/s

## Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktbasismaterial	Kupferlegierung	Kontaktmaterial	Gold über Nickel
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	80 °C		

## Verpackungen

Verpackung	Rolle	VPE Länge	0
VPE Breite	0	VPE Höhe	0

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01		

## Downloads

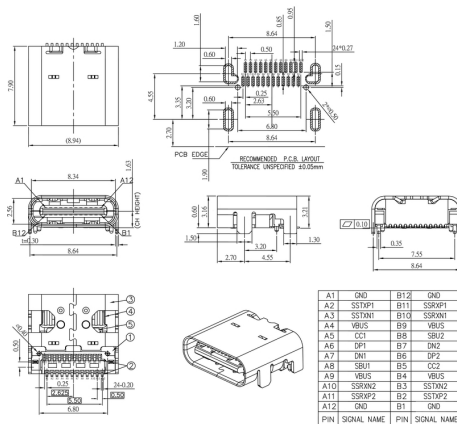
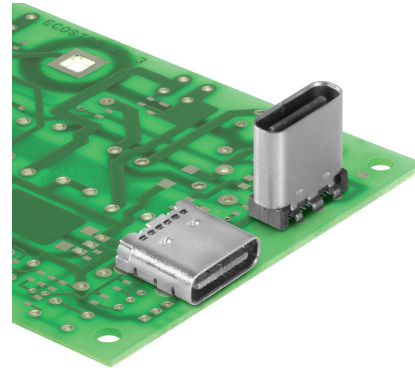
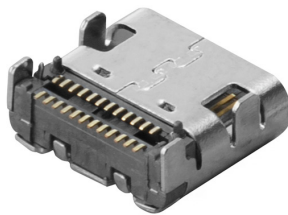
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## USB3.1C S1H DN1 RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**Empfohlenes Reflow-Lötprofil****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt  $\leq +3 \text{ K/s}$ . Parallel dazu wird die Lotpaste „aktiviert“. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei  $\geq -6 \text{ K/s}$  härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.